

### HS-600XAB 系列-大功率 LED 有机硅封装材料

#### 一、产品简介:

- 该产品系双组份有机硅封装材料,此产品消泡性好、绝缘性能高、耐冷热冲击性好、抗 UV 性强、可以长期在-60℃~+200℃稳定工作。主要用于大功率 LED 透镜、模块、SMD 的封装。
- 产品特性及优点:
  - 优异的高温稳定性、在操作及性能上有更高的可靠性。
  - 湿气摄取量低。
  - 低离子含量。
  - 优异的光学特性。
  - 加成固化、无副产物收缩性小。
  - 无溶剂、无危害性散发物。

#### 二、操作工艺注意事项:

使用时请严格按照产品的配比进行配料和搅拌,如果配比出现误差或搅拌不均匀,将直接影响产品的质量。将搅拌好的产品进行真空脱泡 5~10 分钟左右即可使用。配好的 A/B 混合胶液应在 60 分钟以内用完。

#### 三、常规性能:

产品型号	HS-6001A/B	HS-6002A/B	HS-6003A/B
应用范围	透镜填充	SMD 封装	透镜填充
混合比例 (重量比)	1:1	1:1	1:1
固化条件 °C hrs	25°C/8 hrs	100°C/2hrs +150°C/4hrs	80°C/1 hrs +120°C/2 hrs
混合料可使用时间 (25°C/ hrs)	1.0	2.0	2.0
粘度 40°C/mpa.s	3000/2500	6000/1000	2000/3000
外观	透明	透明	透明
密度 25°C/g/cm <sup>3</sup>	1~1.1	1~1.1	1~1.1
固化后特性	透明弹性体	透明弹性体	透明弹性体
硬度 shore-A	25~30	70	25~30
绝缘强度 25°C, kv/mm	>25	>25	>25
吸水性 25°C/24/h, %	<0.1	<0.1	<0.1
导热系数 (wats/neter-°C)	0.2~0.3	0.2~0.3	0.2~0.3
延伸率 ( % )	80	40	90
拉伸强度 (Mpa)	10~12	10~12	10~12
折射率 nm	1.48~1.50	1.5~1.53	1.5~1.53
体积电阻率 25°C, Ω, cm	1.0×10 <sup>15</sup>	1.0×10 <sup>15</sup>	1.0×10 <sup>15</sup>
透光率 ( % )	98	98	98
Tg°C	-125~130	-125~130	-125~130
保质期 25°C	12 个月	12 个月	12 个月

四、储存、运输及注意事项:

此类产品属于非危险品,按一般化学品运输。

室内 25℃以下储存在阴凉通风远离火源的区域。

五、包装规格:

A/B 都为 0.5KG/塑料瓶包装。

六、性能测试环境:

以上性能数据为该产品测试环境温度湿度为 70%、温度为 25℃测试之数据,仅供客户使用时参考,并不能完全保证某个数据能完全达到全部所测数据,请客户使用时以实测数据为准。